

# Dell EMC PowerEdge R6525

## 仕様詳細

## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータ ロスの可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

<b>章 1: 仕様詳細</b> .....	<b>4</b>
シャーシ寸法.....	5
システムの重量.....	6
プロセッサの仕様.....	6
PSU の仕様.....	6
対応オペレーティング システム.....	6
冷却ファンの仕様.....	7
システム バッテリーの仕様.....	11
拡張カードライザーの仕様.....	11
メモリーの仕様.....	12
ストレージコントローラーの仕様.....	12
ドライブの仕様.....	13
ドライブ.....	13
ポートおよびコネクタの仕様.....	13
USB ポートの仕様.....	13
NIC ポートの仕様.....	14
シリアル コネクタの仕様.....	14
VGA ポートの仕様.....	14
IDSDM.....	14
ビデオの仕様.....	14
環境仕様.....	15
温度通気の制限.....	16
温度に関する制限のマトリックス.....	17

# 仕様詳細

本項では、お使いのシステムの技術仕様と環境仕様の概要を示します。

## トピック：

- シャーシ寸法
- システムの重量
- プロセッサの仕様
- PSU の仕様
- 対応オペレーティング システム
- 冷却ファンの仕様
- システム バッテリーの仕様
- 拡張カードライザーの仕様
- メモリーの仕様
- ストレージコントローラーの仕様
- ドライブの仕様
- ポートおよびコネクタの仕様
- ビデオの仕様
- 環境仕様

# シャーシ寸法

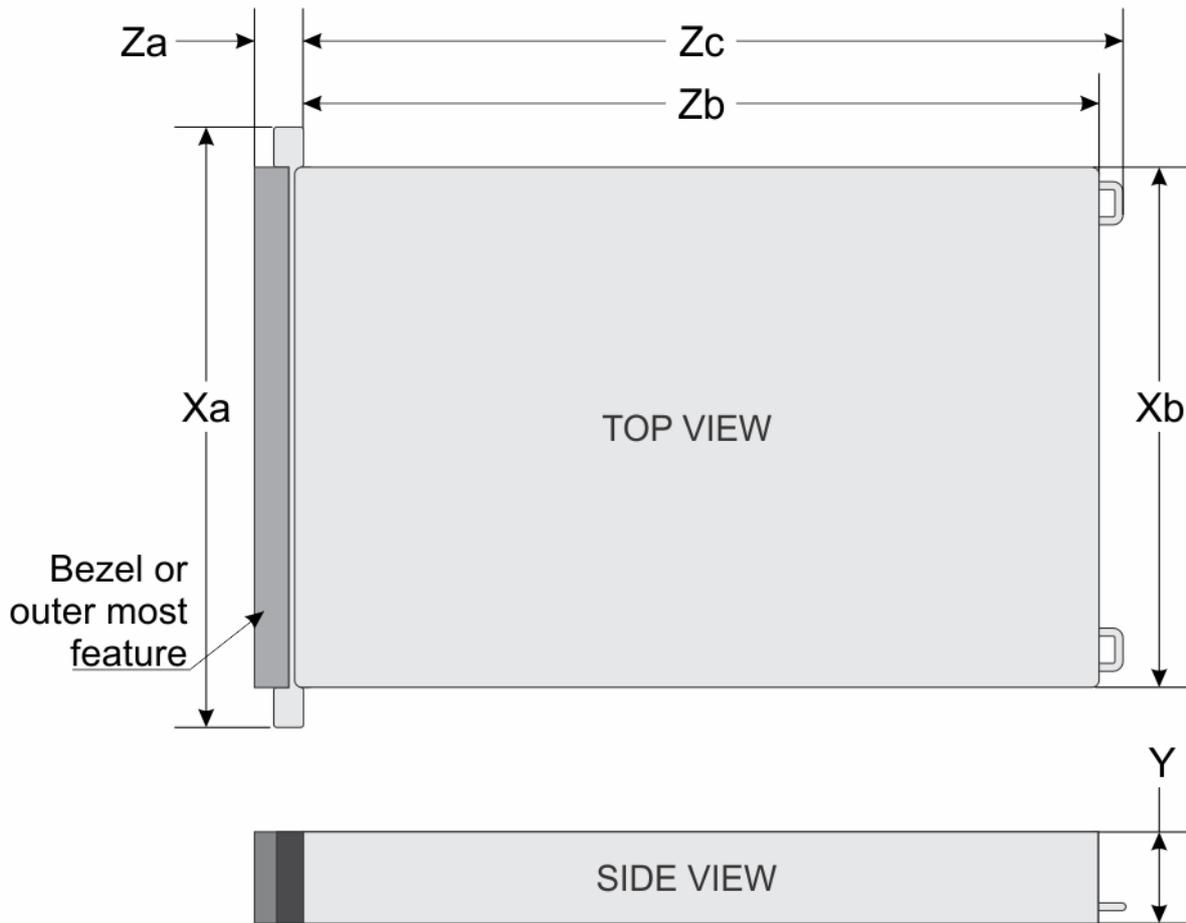


図 1. シャーシ寸法

表 1. PowerEdge R6525 のシャーシの寸法

ドライブ	Xa	Xb	Y	Za	Zb*	Zc
8 台のドライブ	482.0 mm ( 18.97 インチ )	434.0 mm ( 17.08 インチ )	42.8 mm ( 1.68 インチ )	ベゼル込み : 35.84 mm ( 1.4 インチ ) ベゼル込み : 22.0 mm ( 0.87 インチ )	700.53 mm ( 27.58 インチ ) ( 耳から背面ウ ォールまで )	736.27 mm ( 28.98 インチ ) ( 耳から PSU ハンドルまで )
4 台または 10 台 のドライブ	482.0 mm ( 18.97 インチ )	434.0 mm ( 17.08 インチ )	42.8 mm ( 1.68 インチ )	ベゼル込み : 35.84 mm ( 1.4 インチ ) ベゼル込み : 22.0 mm ( 0.87 インチ )	751.48 mm ( 29.58 インチ ) ( 耳から I/O ラ ベルまで )	787.05 mm ( 30.98 インチ ) ( 耳から PSU ハンドルまで )

① **メモ:** Zb\*は、システム ボード I/O コネクタが設置されている公称背面外部表面を示します。

# システムの重量

表 2. PowerEdge R6525 システムの重量

システム設定	最大重量 (すべてのドライブ/SSD を含む)
4 x 3.5 インチ	21.8 kg ( 48.06 ポンド )
8 x 2.5 インチ	19.2 kg ( 42.33 ポンド )
10 x 2.5 インチ	21.8 kg ( 48.06 ポンド )

# プロセッサの仕様

表 3. PowerEdge R6525 プロセッサ仕様

サポートされるプロセッサ	サポートされているプロセッサ数
AMD EPYC 7002 シリーズ プロセッサまたは 7003 シリーズ プロセッサ	2 台

# PSU の仕様

PowerEdge R6525 システムは、最大 2 台の AC または DC 電源装置ユニット ( PSU ) をサポートします。

**⚠ 警告:** 資格を持つ電気技師限定の手順 :

-( 48 ~ 60 ) V DC または 240 V DC 電源装置を使用するシステムは、National Electrical Code、American National Standards Institute ( ANSI ) / National Fire Protection Association ( NFPA ) 70 の 110-5、110-6、110-11、110-14、および 110-17 項に従った立入制限区域に設置してください。

240 V DC 電源装置は、使用している国で適用可能であれば、認定済みの配電ユニットから 240 V DC コンセントに接続します。

電源コード/ジャンパコードとそれに付随するプラグ/インレット/コネクタを接続して使用する場合、システムの定格ラベルに示された適切な電気定格があるものとします。

表 4. PowerEdge R6525 PSU の仕様

PSU	クラス ( AC のみ )	熱消費 ( 最大 )	周波数	電圧	現在
800 W 混合モード	プラチナ	3000 BTU/時	50/60 Hz	AC100 ~ 240 V	9.2 ~ 4.7 A
	該当なし		DC	DC 240 V	3.8 A
1100 W 混合モード	チタニウム	4100 BTU/時	50/60 Hz	AC100 ~ 240 V	12 A ~ 6.3 A ( X2 )
	該当なし		DC	DC 240 V	DC5.2 A
1100 W ( DC -48V )	該当なし	4265 BTU/hr	DC	DC ( -48 ) ~ ( -60 ) V	27 A
1400 W 混合モード	プラチナ	5250 BTU/時	50/60 Hz	AC100 ~ 240 V	AC12 ~ 8 A
	該当なし		DC	DC 240 V	DC6.6 A

**📌 メモ:** システム構成を選択またはアップグレードする場合は、最適な電力使用率を達成できるように、[ Dell.com/ESSA ] で入手できる Dell Energy Smart Solution Advisor でシステムの電力消費量を検証します。

# 対応オペレーティング システム

PowerEdge R6525 は、次のオペレーティング システムをサポートしています。

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix XenServer
- Hyper-V 搭載 Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware vSAN/ESXi

詳細については、[www.dell.com/ossupport](http://www.dell.com/ossupport) を参照してください。

## 冷却ファンの仕様

PowerEdge R6525 システムでは、最大 4 台の標準 (STD)、ハイパフォーマンス シルバー グレード (HPR (シルバー))、またはハイパフォーマンス ゴールド グレード (HPR (ゴールド)) のデュアル冷却ファン モジュールをサポートしています。

表 5. 冷却ファンの仕様

ファンのタイプ	略語	別名	ラベルの色	ラベルの画像
標準ファン	STD	STD	ラベルなし	 <p>図 2. 標準ファン</p>
ハイパフォーマンス (シルバーグレード) ファン	HPR (シルバー)	HPR	シルバー	<p><b>メモ:</b> 新しい冷却ファンには、ハイパフォーマンス シルバーグレードのラベルが付いています。古い冷却ファンには、ハイパフォーマンスのラベルが付いています。</p>

表 5. 冷却ファンの仕様 ( 続き )

ファンのタイプ	略語	別名	ラベルの色	ラベルの画像
				

図 3. ハイ パフォーマンス ファン

表 5. 冷却ファンの仕様 ( 続き )

ファンのタイプ	略語	別名	ラベルの色	ラベルの画像
				
ハイパフォーマンス (ゴールドグレード) ファン	HPR (ゴールド)	VHP: 超ハイパフォーマンス	ゴールド	<p>① <b>メモ:</b> 新しい冷却ファンには、ハイパフォーマンス ゴールドグレードのラベルが付いています。古い冷却ファンには、ハイパフォーマンスのラベルが付いています。</p>

図 4. ハイパフォーマンス ( シルバーグレード ) ファン

表 5. 冷却ファンの仕様 ( 続き )

ファンのタイプ	略語	別名	ラベルの色	ラベルの画像
				

図 5. ハイ パフォーマンス ファン

表 5. 冷却ファンの仕様 ( 続き )

ファンのタイプ	略語	別名	ラベルの色	ラベルの画像
				

図 6. ハイパフォーマンス ( ゴールドグレード ) ファン

- ① **メモ:** ハイパフォーマンス ( シルバー ) ファンとハイパフォーマンス ( ゴールド ) ファンは、ラベルの色で区別できます。
- ① **メモ:** STD ファン、HPR ( シルバー ) ファン、HPR ( ゴールド ) ファンの混在はサポートされていません。
- ① **メモ:** STD ファン、HPR ( シルバー ) ファン、HPR ( ゴールド ) ファンの取り付けは、システム構成によって異なります。サポートされるファンの構成またはマトリックスの詳細については、「[温度制限マトリックス](#)」を参照してください。

## システム バッテリーの仕様

PowerEdge R6525 システムは、CR 2032 3.0-V コイン型リチウム電池システム バッテリーをサポートします。

## 拡張カードライザーの仕様

**警告:** エンタープライズ サーバー製品では、コンシューマーグレードの GPU を取り付けたり使用したりすることはできません。

PowerEdge R6525 システムは、最大 4 個の PCI express ( PCIe ) Gen 4 拡張カードをサポートします。

表 6. システム ボードで使用できる拡張カード スロット

PCIe スロット	ライザー	ライザーの幅	PCIe スロットの高さ	PCIe スロットの長さ	スロット幅
スロット 1	R2a (ライザー 2)	x32 PCIe	ロープロファイル	ハーフ レングス	x16
スロット 1	R1a (ライザー 1)	x16 PCIe	フル ハイト	3/4 レングス	x16
スロット 2	R2a (ライザー 2)	x32 PCIe	ロープロファイル	ハーフ レングス	x16
スロット 2	R4c + R4d (ライザー 4)	x16 PCIe	フル ハイト	3/4 レングス	x16
スロット 3	R3a (ライザー 3)	x16 PCIe	ロープロファイル	ハーフ レングス	x16

## メモリーの仕様

PowerEdge R6525 システムは、動作を最適化するために次のメモリ仕様をサポートしています。

表 7. メモリーの仕様

DIMM のタイプ	DIMM のランク	DIMM の容量	シングルプロセッサ		デュアルプロセッサ	
			最小 RAM	最大 RAM	最小 RAM	最大 RAM
RDIMM	シングルランク	8 GB	8 GB	128 GB	16 GB	256 GB
	デュアルランク	16 GB	16 GB	256 GB	32 GB	512 GB
		32 GB	32 GB	512 GB	64 GB	1 TB
		64 GB	64 GB	1 TB	128 GB	2 TB
LRDIMM	クワッドランク	128 GB	128 GB	2 TB	256 GB	4 TB
	オクタランク	128 GB	128 GB	2 TB	256 GB	4 TB

① **メモ:** 同一の AMD EPYC™ プロセッサ ユニットにおいて、データ幅 x4、DRAM 密度 8Gb の古い 32 GB 容量の RDIMM メモリーと、データ幅 x8、DRAM 密度 16Gb の新しい 32 GB 容量の RDIMM メモリーを混在させることはできません。

① **メモ:** 速度 2666 MT/s の古い 128 GB 容量の LRDIMM メモリーと、速度 3200 MT/s の新しい 128 GB 容量の LRDIMM メモリーを混在させることはできません。

表 8. メモリモジュールソケット

メモリモジュールソケット	速度
32、288 ピン	3200 MT/s、2933 MT/s、2666 MT/s

## ストレージコントローラーの仕様

PowerEdge R6525 システムは次のコントローラー カードをサポートしています。

表 9. PowerEdge R6525 システム コントローラー カード

内部コントローラ	外部コントローラー
<ul style="list-style-type: none"> <li>PERC H755N</li> <li>PERC H745</li> <li>HBA345</li> <li>HBA355</li> <li>S150</li> <li>H345</li> <li>Boot Optimized Storage Subsystem ( BOSS-S1 ) : HWRAID 2 x M.2 SSD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 Gbps SAS Ext.HBA</li> <li>PERC H840</li> <li>HBA355E</li> </ul>

表 9. PowerEdge R6525 システム コントローラー カード

内部コントローラ	外部コントローラ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boot Optimized Storage Subsystem ( BOSS-S2 ): HWRAID 2 x M.2 SSD</li> </ul>	

- ① **メモ:** PowerEdge R6525 システムの前面 PERC モジュールは、ドライブ バックプレーンに接続します。前面 PERC モジュールは、次の 2 種類の方法で接続されます。
- 前面取り付け前面 PERC モジュール
  - 背面取り付け前面 PERC モジュール

## ドライブの仕様

### ドライブ

PowerEdge R6525 システムは、次をサポートしています。

- 4 x 3.5 インチ ホットスワップ対応 SAS、SATA ドライブ
- 8 x 2.5 インチ ホットスワップ対応 SAS、SATA ドライブ
- 10 x 2.5 インチ ホットスワップ対応 SAS、SATA、または NVMe ドライブ
- 10 + 2 x 2.5 インチ ホットスワップ対応 SAS、SATA、または NVMe ドライブ

バックプレーン :

- 最大 2 x 2.5 インチの SAS、SATA、または NVMe ドライブ
- 最大 4 台の 3.5 インチ SAS、SATA ドライブ
- 最大 8 台の 2.5 インチ SAS、SATA ドライブ
- 最大 10 台の 2.5 インチ SAS、SATA、または NVMe ドライブ

- ① **メモ:** NVMe PCIe SSD U.2 デバイスをホット スワップする方法の詳細については、<https://www.dell.com/support> [ 全製品の閲覧 ] > [ データ センター インフラストラクチャ ] > [ ストレージ アダプターとコントローラー ] > [ Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD ] > [ ドキュメント ] > [ マニュアルとドキュメント ] から、*Dell Express Flash NVMe PCIe SSD ユーザーズ ガイド*を参照してください。

## ポートおよびコネクタの仕様

### USB ポートの仕様

表 10. PowerEdge R6525 システムの USB の仕様

正面		背面		内蔵	
USB ポートタイプ	番号ポート数	USB ポートタイプ	番号ポート数	USB ポートタイプ	番号ポート数
USB 2.0 対応ポート	1 回	USB 3.0 対応ポート	1 回	内蔵 USB 3.0 対応ポート	1 回
Micro USB 2.0 対応ポート	1 回	USB 2.0 対応ポート	1 回		

- ① **メモ:** Micro USB 2.0 対応ポートは、iDRAC Direct または管理ポートとしてのみ使用できます。

- ① **メモ:** USB 2.0 の仕様では、単一のワイヤに 5 V の電力を供給して、接続されている USB デバイスに電源を供給します。ユニットのロードは、USB 2.0 では 100 mA、USB 3.0 では 150 mA に定義されています。デバイスでは、USB 2.0 のポートから最大 5 ユニット ロード ( 500 mA ) を引き出し、USB 3.0 のポートから最大 6 ユニット ロード ( 900 mA ) を引き出す可能性があります。

**メモ:** USB 2.0 のインターフェイスにより、低電力の周辺機器類に電力を供給できますが、USB の仕様に準拠している必要があります。外部の CD/DVD ドライブといった高電力の周辺機器類を機能させるには、外部の電源が必要です。

## NIC ポートの仕様

PowerEdge R6525 システムでは、LAN on Motherboard ( LOM ) に組み込まれ、オプションの OCP カードに内蔵された 10/100/1000 Mbps ネットワーク インターフェイス コントローラ ( NIC ) ポートを最大 2 個サポートします。

表 11. NIC ポートの仕様

特長	仕様
LOM カード	2 x 1 GB
OCP カード ( OCP 3.0 )	4 x 1 GbE、2 x 10 GbE、2 x 25 GbE、4 x 25 GbE、2 x 50 GbE、2 x 100 GbE

## シリアルコネクタの仕様

PowerEdge R6525 システムは、オプションでカードタイプのシリアルコネクタ 1 個をサポートしています。このコネクタは、9 ピンコネクタ、データ端末装置 ( DTE )、16550 準拠です。

オプションのシリアルコネクタカードは、拡張カード フィラーブラケットと同じ手順で取り付けられます。

## VGA ポートの仕様

PowerEdge R6525 システムは、システムの前面パネルと背面パネルにある 1 つの DB-15 VGA ポートをサポートします。

## IDSDM

PowerEdge R6525 システムは、オプションの内蔵デュアル SD モジュール ( IDSDM ) をサポートしています。

IDSDM は 2 枚の SD カードをサポートしており、次の構成で使用できます。

表 12. サポートされている SD カードのストレージ容量

IDSDM カード
<ul style="list-style-type: none"><li>16 GB</li><li>32 GB</li><li>64 GB</li></ul>

**メモ:** IDSDM カード スロット 1 個は冗長専用です。

**メモ:** IDSDM が設定されたシステムに紐付いた Dell EMC ブランドの SD カードを使用します。

## ビデオの仕様

PowerEdge R6525 システムは、16 MB のビデオ フレーム バッファを備えた内蔵 Matrox G200 グラフィックス コントローラをサポートします。

表 13. サポートされている前面ビデオ解像度のオプション

解像度	リフレッシュレート ( Hz )	色深度 ( ビット )
1024 x 768	60	8、16、32
1280 x 800	60	8、16、32

表 13. サポートされている前面ビデオ解像度のオプション ( 続き )

解像度	リフレッシュレート ( Hz )	色深度 ( ビット )
1280 x 1024	60	8、16、32
1360 x 768	60	8、16、32
1440 x 900	60	8、16、32
1600 x 900	60	8、16、32
1600 x 1200	60	8、16、32
1680 x 1050	60	8、16、32
1920 x 1080	60	8、16、32
1920 x 1200	60	8、16、32

表 14. サポートされている背面ビデオ解像度のオプション

解像度	リフレッシュレート ( Hz )	色深度 ( ビット )
1024 x 768	60	8、16、32
1280 x 800	60	8、16、32
1280 x 1024	60	8、16、32
1360 x 768	60	8、16、32
1440 x 900	60	8、16、32
1600 x 900	60	8、16、32
1600 x 1200	60	8、16、32
1680 x 1050	60	8、16、32
1920 x 1080	60	8、16、32
1920 x 1200	60	8、16、32

## 環境仕様

① **メモ:** 環境認証の詳細については、[www.dell.com/support/home](http://www.dell.com/support/home) のマニュアルおよび文書にある「製品環境データシート」を参照してください。

表 15. 動作環境範囲カテゴリ - A2

温度	仕様
許容可能な継続動作	
高度 <= 900 m ( <= 2,953 ft ) の温度範囲	10 ~ 35°C ( 50 ~ 95°F )、装置への直射日光なし。
湿度範囲 ( 常に結露なし )	8% RH で最低露点 -12°C、80% RH で最大露点 21°C ( 69.8°F )
動作高度減定格	900 m ( 2,953 Ft ) を越える高度では、最高温度は 300 m ごとに 1°C ( 984 Ft ごとに 1.8°F ) 低くなります。

表 16. 動作環境範囲カテゴリ - A3

温度	仕様
許容可能な継続動作	
高度 <= 900 m ( <= 2,953 ft ) の温度範囲	5°C ~ 40°C ( 41°C ~ 104°F )、装置への直射日光なし
湿度範囲 ( 常に結露なし )	8% RH で最低露点 -12°C、85% RH で最大露点 24°C ( 75.2°F )

表 16. 動作環境範囲カテゴリ A3 ( 続き )

温度	仕様
動作高度減定格	900 m ( 2,953 Ft ) を越える高度では、最高温度は 175 m ごとに 1°C ( 574 Ft ごとに 1.8°F ) 低くなります。

表 17. 動作環境範囲カテゴリ A4

温度	仕様
許容可能な継続動作	
高度 <= 900 m ( <= 2,953 ft ) の温度範囲	5°C ~ 45°C ( 41°F ~ 113°F )、装置への直射日光なし
湿度範囲 ( 常に結露なし )	8% RH で最低露点 -12°C、90% RH で最大露点 24°C ( 75.2°F )
動作高度減定格	900 m ( 2,953 Ft ) を越える高度では、最高温度は 125 m ごとに 1°C ( 410 Ft ごとに 1.8°F ) 低くなります。

表 18. すべてのカテゴリに共通する要件

温度	仕様
許容可能な継続動作	
最大温度勾配 ( 動作時と非動作時の両方に適用 )	1 時間で 20°C ( 1 時間で 36°F )、15 分間で 5°C ( 15 分間で 9°F )、テープハードウェアの場合は 1 時間で 5°C ( 1 時間で 9°F ) <b>①メモ:</b> * : テープハードウェアの ASHRAE 温度ガイドラインにより、これらは温度変化の瞬間レートではありません。
非動作時の温度制限	-40 ~ 65°C ( -40~149°F )
非動作時の湿度制限	5 ~ 95% RH で最大露点 27°C ( 80.6°F )
非動作時の最大高度	12,000 メートル ( 39,370 フィート )
動作時の最大高度	3,048 メートル ( 10,000 フィート )

表 19. 最大振動の仕様

最大耐久震度	仕様
動作時	0.21 G <sub>rms</sub> ( 5 ~ 500 Hz ) ( 全稼働方向 )
ストレージ	1.88 G <sub>rms</sub> ( 10Hz ~ 500 Hz ) で 15 分間 ( 全 6 面で検証済 )

表 20. 最大衝撃パルス仕様

最大衝撃パルス	仕様
動作時	x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス、11 ミリ秒以下で 6 G。
ストレージ	x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス ( システムの各面に対して 1 パルス )、2 ミリ秒以下で 71 G。

## 温度通気の制限

### ASHRAE A3 環境

- 180 W 以上の CPU TDP はサポートされていません。
- 背面ドライブはサポートされていません。
- 128 GB 以上の容量の LRDIMM はサポートされていません。
- 冗長モードでは 2 台の PSU が必要です。ただし、PSU の障害はサポートされていません。
- Dell 認定外の周辺機器カードおよび / または 25 W を超える周辺機器カードは非対応です。
- GPU は非対応です。
- BOSS 1.5 はサポートされていません。

- NVMe はサポートされていません。

## ASHRAE A4 環境

- 155 W 以上の CPU TDP はサポートされていません。
- 背面ドライブはサポートされていません。
- 128 GB 以上の容量の LRDIMM はサポートされていません。
- 冗長モードでは 2 台の PSU が必要です。ただし、PSU の障害はサポートされていません。
- Dell 認定外の周辺機器カードおよび/または Tier 5 を超える周辺機器カードはサポートされていません。
- GPU は非対応です。
- BOSS 1.5 はサポートされていません。
- OCP 3.0 カードの冷却階層が Tier4 を超える場合はサポートされていません。
- NVMe はサポートされていません。

## 液体冷却 : ASHRAE A3 環境

- 128 GB 以上の容量の LRDIMM はサポートされていません。
- 冗長モードでは 2 基の PSU が必要です。ただし、PSU の障害はサポートされていません。
- Dell 認定外の周辺機器カードおよび / または 25 W を超える周辺機器カードは非対応です。
- GPU は非対応です。
- BOSS 1.5 はサポートされていません。
- NVMe はサポートされていません。

## 液体冷却 : ASHRAE A4 環境

- 背面ドライブはサポートされていません。
- 128 GB 以上の容量の LRDIMM はサポートされていません。
- 冗長モードでは 2 基の PSU が必要です。ただし、PSU の障害はサポートされていません。
- Dell 認定外の周辺機器カードおよび/または Tier 5 を超える周辺機器カードはサポートされていません。
- OCP 3.0 カードの冷却階層が Tier 4 を超える場合はサポートされていません。
- GPU は非対応です。
- BOSS 1.5 はサポートされていません。
- NVMe はサポートされていません。

## 温度に関する制限のマトリックス

表 21. 温度に関する制限のマトリックス

構成		4 x 3.5 インチ			8 x 2.5 インチ		10 x 2.5 インチ SAS			10 x 2.5 インチ NVMe	
背面構成		3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ SAS	背面 2 x 2.5 インチ NVMe	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ NVMe (シングルプロセッサ)	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ SAS	背面 2 x 2.5 インチ NVMe	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ NVMe
CPU TDP	CPU cTDP Max										
120 W	150 W	STD ファン STD HSK	HPR ファン STD HSK	HPR ファン STD HSK	STD ファン STD HSK	HPR ファン STD HSK	VHP ファン STD HSK	VHP ファン STD HSK	VHP ファン STD HSK	VHP ファン STD HSK	VHP ファン STD HSK
155 W	180 W	STD ファン	HPR ファン	HPR ファン	STD ファン	HPR ファン	VHP ファン	VHP ファン	VHP ファン	VHP ファン	VHP ファン

表 21. 温度に関する制限のマトリックス ( 続き )

構成		4 x 3.5 インチ			8 x 2.5 インチ		10 x 2.5 インチ SAS			10 x 2.5 インチ NVMe	
背面構成		3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ SAS	背面 2 x 2.5 インチ NVMe	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ NVMe ( シングルプロセッサ )	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ SAS	背面 2 x 2.5 インチ NVMe	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ NVMe
CPU TDP	CPU cTDP Max										
		STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK				
180 W	200 W	HPR ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK				
200 W	200 W	HPR ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK				
225 W	240 W	HPR ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK				
280 W : 64C ( 7H12、7763 )		HPR ファン* L 字型 HSK	HPR ファン* L 字型 HSK	HPR ファン* L 字型 HSK	HPR ファン L 字型 HSK	HPR ファン* L 字型 HSK	VHP ファン* L 字型 HSK	VHP ファン* L 字型 HSK	VHP ファン* L 字型 HSK	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン* L 字型 HSK
280 W : 32C ( 75F3 )		-	-	-	VHP ファン* L 字型 HSK	-	VHP ファン* L 字型 HSK	-	-	VHP ファン* L 字型 HSK	-
280 W - 64C/32C/24C 280 W ( 7773X、 7573X、7473X )		-	-	-	-	-	VHP ファン L 字型 HSK	VHP ファン* L 字型 HSK	VHP ファン* L 字型 HSK	-	-
280 W - 16C 280 W ( 7373X )		-	-	-	-	-	VHP ファン** L 字型 HSK	-	-	-	-
T4 GPU または A2 GPU		HPR ファン*	HPR ファン*	HPR ファン*	HPR ファン*	-	VHP ファン*	VHP ファン*	VHP ファン*	VHP ファン*	VHP ファン*

①メモ: \* サポートされている周囲温度は 30°C です。

① **メモ:** \*\* サポートされている周囲温度は 25°C です。

表 22. 液体冷却の温度に関する制限のマトリックス

構成		4 x 3.5 インチ			8 x 2.5 インチ	10 x 2.5 インチ SAS			10 x 2.5 インチ NVMe	
背面ストレージ		3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ SAS	背面 2 x 2.5 インチ NVMe	3 LP/2 FH	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ SAS	背面 2 x 2.5 インチ NVMe	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 インチ NVMe
CPU TDP	CPU cTDP Max									
120 W	150 W	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン
155 W	180 W	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン
180 W	200 W	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン
200 W	200 W	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン
225 W	240 W	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン
280 W	280 W	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン
T4 GPU		HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン	HPR ファン

① **メモ:** シングル プロセッサには 3 個のデュアルファン モジュールが必要で、デュアル プロセッサ システムでは 4 個のデュアルファン モジュールが必要です。

① **メモ:** T4 の GPU および 280 W の CPU でサポートされている最大周囲温度は 30°C です。その他の構成でサポートされている最大周囲温度は 35°C です。

表 23. プロセッサとヒートシンク マトリックス

ヒートシンク	プロセッサ TDP
STD HSK	< 180 W
L 字型 HSK	プロセッサ 1 >= 180 W
L 字型 HSK	プロセッサ 2 >= 180 W

表 24. プロセッサ サポート マトリックス

プロセッサ	TDP (W)	cTDP Max (W)	コア	ヒートシンク (HSK) タイプ	ファンの種類 (x4/x8)	ファンの種類 (x10)	サポート A3	サポート A4
7773X	280	280	64	L 字型 HSK	NA	HPR(ゴールド)ファン	無	無
7573X	280	280	32	L 字型 HSK	NA	HPR(ゴールド)ファン	無	無
7H12	280	280	64	L 字型 HSK	HPR(シルバー)ファン	HPR(ゴールド)ファン	無	無
7F72	240	240	24	L 字型 HSK	HPR(シルバー)ファン	HPR(ゴールド)ファン	無	無
7F52	225	240	16	L 字型 HSK	HPR(シルバー)ファン	HPR(ゴールド)ファン	無	無

表 24. プロセッサ サポート マトリックス ( 続き )

プロセッサ	TDP ( W )	cTDP Max ( W )	コア	ヒートシンク ( HSK ) タイプ	ファンの種類 ( x4/x8 )	ファンの種類 ( x10 )	サポート A3	サポート A4
7662	225	240	64	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7643	240	240	56	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7742	225	240	64	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7713P	225	240	64	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7642	225	240	48	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7552	200	200	48	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7702	200	200	64	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7663	240	240	56	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7543P	225	240	32	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7542	225	240	32	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7532	200	200	32	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7F32	180	180	8	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7513	200	200	32	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7502	180	200	32	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
74F3	240	240	24/48	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7402	180	200	24	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7452	155	180	32	STD HSK	STD ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	有	無
7443P	200	200	24	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7443	200	200	24	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7352	155	180	24	STD HSK	STD ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	有	無
7343	200	200	32	L 字型 HSK	HPR( シルバ ー ) ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	無	無
7313P	155	180	16	STD HSK	STD ファン	HPR( ゴール ド ) ファン	有	無

表 24. プロセッサ サポート マトリックス ( 続き )

プロセッサ	TDP ( W )	cTDP Max ( W )	コア	ヒートシンク ( HSK ) タイプ	ファンの種類 ( x4/x8 )	ファンの種類 ( x10 )	サポート A3	サポート A4
7302	155	180	16	STD HSK	STD ファン	HPR( ゴールド ) ファン	有	無
72F3	180	200	8	L 字型 HSK	HPR( シルバー ) ファン	HPR( ゴールド ) ファン	無	無
7282	120	150	16	STD HSK	STD ファン	HPR( ゴールド ) ファン	有	有
7272	120	150	12	STD HSK	STD ファン	HPR( ゴールド ) ファン	有	有
7252	120	150	8	STD HSK	STD ファン	HPR( ゴールド ) ファン	有	有
7262	155	180	8	STD HSK	STD ファン	HPR( ゴールド ) ファン	有	無

① | **メモ:** 280 W の CPU が取り付けられている場合は、空のロットに DIMM ブランクが必要です。

① | **メモ:** プロセッサ 7573X および 7773X は、x10 SAS/SATA ドライブのみをサポートします。

表 25. T4 GPU のサポート制限

背面の構成	2.5 インチ x 10		2.5 インチ x 8		3.5 インチ x 4	
	3 x LP	2 x FH	3 x LP	2 x FH	3 x LP	2 x FH
スロット 1	対応	対応	対応	対応	対応	対応
スロット 2	対応	対応	対応	対応	対応	対応
スロット 3	対応	NA	非対応	NA	非対応	NA

① | **メモ:** 128 GB LRDIMM 3200 MT/s 以上のメモリーは、280 W T4/A2 構成ではサポートされていません。

表 26. ラベル参照

ラベル	説明
STD	標準
HPR	ハイ パフォーマンス ( シルバー グレード )
VHP	超ハイ パフォーマンス ( ゴールド グレード )
HSK	ヒートシンク
LP	ロープロファイル
FH	フルハイト